

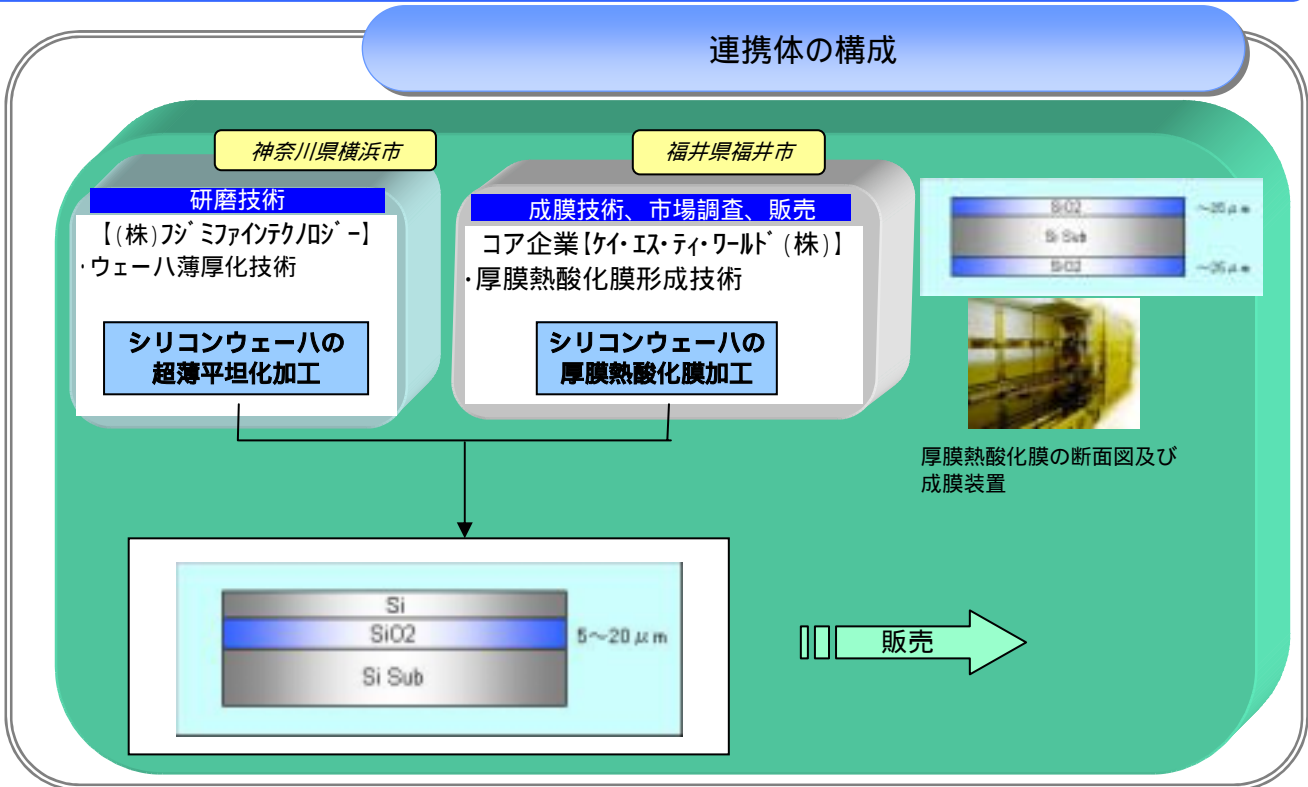
地域	近畿	事業分野	製造	認定日	平成 18 年 2 月 22 日
----	----	------	----	-----	------------------

テーマ名: 半導体デバイス用厚膜熱酸化膜付きシリコンウェーハ成膜事業

事業計画の概要:

- ・ケイ・エス・ティ・ワールド(株)の独自技術による「シリコンウェーハに厚膜熱酸化膜を形成する技術(特許取得済)」と、異分野のビジネスパートナー(株)フジミファインテクノロジーの「シリコンウェーハの高平坦度技術」を用いて、高い需要が見込める各種マイクロマシンや車載用デバイスなど幅広い用途の半導体デバイス用基板を開発・製造・販売を行う。

コア企業: ケイ・エス・ティ・ワールド (株)
 連携企業等: (株)フジミファインテクノロジー



連携の特徴

ケイ・エス・ティ・ワールド(株)は、独自技術の「厚膜熱酸化膜法」を用い、光通信デバイスのクラッド層を形成することに成功。
 (株)フジミファインテクノロジーは、少量多品種のパターン付ウェーハの研削研磨の加工経験で培った技術・ノウハウを駆使し標準以外の特殊加工に強みをもつ。

新事業

(従来) 光通信デバイス
 ↓ +シリコンウェーハの高平坦度技術
 (今後) MEMS、車載用デバイス

市場性

MEMS用基板市場
 車載用デバイス用基板市場

支援予定メニュー

補助金、新連携融資、信用保証の特例、中小企業投資育成会社による支援、特許料減免